

GMM-Fachgruppe 1.2.3 Abscheide- und Ätzverfahren

24. Workshop

Wednesday, December 7, 2022

Fraunhofer IISB, Schottkystraße 10, 91058 Erlangen, Germany

9:00 **Welcome**

Werner Robl, *Infineon Technologies AG, Regensburg, Germany*
Susanne Oertel, *Fraunhofer IISB, Erlangen, Germany*

Wide Bandgap, umweltschonende und nachhaltige Halbleitertechnologie

9:10 **SiC Power MOS Technology Evolution - Sustainable and Efficient Energy Conversion in DC Grids**

Tobias Erlbacher, *Fraunhofer IISB, Erlangen, Germany*

9:40 **SiC Metrology Challenges & Solutions**

Bernhard Botters, *KLA Instruments Group, Unterhaching, Germany*

10:10 **SiC Etch & Plasma Dicing Preparation**

Joanne Carpenter, *SPTS Technologies, Newport, United Kingdom*

10:40 Coffee Break

11:00 **Atomic Layer Processing: Interplay between Atomic Layer Deposition and Atomic Layer Etching on the Example of AlGaIn/GaN HEMT Structures**

Fransziska Beyer, *Fraunhofer IISB, THM, Freiberg, Germany*

11:30 **DCVD V(I) Measurements with Topography**

Helmut Schönherr, *Infineon Technologies Austria, Villach, Austria*

11:50 **In-situ Metrology for Sub-nm Precision in Plasma Etch End-pointing**

Marcello Binetti, *LayTec, Berlin, Germany*

12:20 Lunch Break

Derzeitige Herausforderungen hinsichtlich Lieferketten

13:15 **Green Alternatives – Environmental-friendly Processes for DRIE and PECVD Cleaning**

Robert Wieland, *Fraunhofer EMFT, München*

13:45 **Elektronik und Optik – Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Ansprüchen an die Fertigungstechnik**

Victor Brasch, *Q.ANT, Stuttgart, Germany*

14:15 Coffee Break

14:45 **Lieferkettendisruption und wie damit umgehen?**

Manfred Beckers, *Lesker, Dresden, Germany*

15:15 **xParts – ALD-Beschichtungen zum Schutz von Anlagenteilen in Halbleiterfertigungsprozessen**

Kevin Bühlmann, *INFICON, Balzers, Liechtenstein*

15:45 **Final Discussion, Closing Remarks**

16:00 **End of Workshop**